

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明，並不擬亦並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約或其一部分。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

內幕消息

**建議根據特別授權進行人民幣股份發行的初步詢價期
及
招股說明書主要條文概要**

華虹半導體有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文之規定發表本公告。

茲提述本公司日期為二零二二年三月二十一日、二零二二年五月十二日、二零二二年六月二十七日、二零二二年十一月四日、二零二三年一月三十日、二零二三年四月十三日、二零二三年五月十日、二零二三年五月十七日、二零二三年五月二十八日、二零二三年六月七日、二零二三年六月二十八日、二零二三年七月五日及二零二三年七月十四日的公告及本公司日期為二零二二年六月七日、二零二二年六月五日及二零二三年六月二十九日的通函，內容有關（其中包括）人民幣股份發行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有上述公告及通函賦予該等詞彙之相同涵義。

I. 建議進行人民幣股份發行的初步詢價期

如本公司日期為二零二三年六月七日之公告所披露，中國證監會批准本公司建議根據特別授權進行人民幣股份發行註冊的申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日二零二三年七月二十日（九時三十分至十五時）在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。人民幣股份發行的最終發售規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. 招股說明書主要條文概要

人民幣股份發行的招股說明書(「招股說明書」)全文及相關附錄的中文版於二零二三年七月十八日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huahonggrace.com)登載。

招股說明書主要條文概要如下。(以「[●]」方式出現的項目僅於人民幣股份發行的最終發售規模及發行價格確定時方會確定。)

1. 人民幣股份發行概要

- (i) 人民幣股份的類別： 人民幣普通股(A股)
- (ii) 每股人民幣股份的面值： 遵照香港法例第622章公司條例第135條，人民幣股份沒有面值
- (iii) 將予發行的人民幣股份數目： 本公司建議將予發行的人民幣股份數目為407,750,000股(即人民幣股份發行完成後本公司經擴大股本的約23.76%)。超額配售權將不會獲行使。人民幣股份發行僅以發行新股的方式進行
- (iv) 每股人民幣股份的發行價： 人民幣[●]元
- (v) 發行市盈率： [●]倍
- (vi) 人民幣股份發行前的每股人民幣股份淨資產： 人民幣15.17元(按照2022年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者的淨資產除以本次發行前的總股本計算)
- (vii) 人民幣股份發行後的每股人民幣股份淨資產： 人民幣[●]元(按照2022年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算)
- (viii) 發行市淨率： [●]倍

- (ix) 發行方式： 向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式
- (x) 目標認購人： 目標認購人為參與戰略配售的合資格投資者、網下投資者及已於上交所開立賬戶並符合條件的自然人、法人、其他機構投資者(中國法律、法規及監管文件禁止購買者除外)或符合中國證監會、上交所相關資格規定的其他目標認購人
- (xi) 承銷方式： 餘額包銷
- (xii) 募集資金總額及 人民幣[●]元及人民幣[●]元
淨額：
- (xiii) 發行費用概算人民幣股份發行的發行費用包括以下各項：
(附註)：
- (1) 保薦承銷費用：(a)若本次募集資金總額小於或等於人民幣165億元，則保薦承銷費用=募集資金總額×0.31%；(b)若本次募集資金總額大於人民幣165億元但小於或等於人民幣180億元，則保薦承銷費用=(募集資金總額－人民幣165億元)×9%+人民幣5,115萬元；(c)若本次募集資金總額大於人民幣180億元但小於或等於人民幣200億元，則保薦承銷費用=(募集資金總額－人民幣180億元)×3%+人民幣18,615萬元；(d)若本次募集資金總額大於人民幣200億元，則保薦承銷費用=(募集資金總額－人民幣200億元)×1.2%+人民幣24,615萬元
 - (2) 審計、驗資費用：人民幣822.65萬元

(3) 律師費用：人民幣636.00萬元

(4) 用於本次發行的信息披露費用：人民幣590.00萬元

(5) 發行手續費用及其他：人民幣125.05萬元

(xiv) 人民幣股份的上 科創板
市地點：

註：

以上發行費用均含增值稅。各項發行費用可能根據最終發行結果而有所調整。發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金淨額，稅率為0.025%，將結合最終發行情況計算並納入發行手續費。

2. 募集資金的用途

於二零二二年六月二十七日，「有關人民幣股份發行及特別授權的決議案」及「有關人民幣股份發行募集資金用途的決議案」經上屆股東特別大會上審議通過。於二零二三年六月二十六日，「有關人民幣股份發行及特別授權的決議案」之有效性經股東批准後延長至二零二四年六月二十六日。扣除實際發行費用後的募集資金淨額將投資於以下項目：

單位：人民幣億元

序號	項目名稱	投資金額	扣除發行費用後佔募集資金淨額的百分比
1.	華虹製造(無錫)項目	125.00	69.44%
2.	8寸工廠優化升級項目	20.00	11.11%
3.	專業技術創新與研發項目	25.00	13.89%
4.	補充營運資金	10.00	5.56%
	合計	<u>180.00</u>	<u>100.00%</u>

倘人民幣股份發行募集的實際資金淨額(扣除發行費用後)超過相關項目所需的投資金額，本公司將按照有關規定履行必要的程序後將超募資金用於本公司主營業務。倘人民幣股份發行募集的實際資金淨額(扣除發行費用後)少於相關項目所需的投資金額，本公司將通過自籌資金解決資金缺口。

人民幣股份發行的募集資金到位前，本公司可以根據有關項目的進展情況使用自籌資金先行投入上述項目。

募集資金到位後，本公司將置換前期投入的資金，然後用於支付項目的剩餘投資款項。

3. 人民幣股份發行對本公司股權架構的影響

於人民幣股份發行前，本公司於二零二三年六月三十日的已發行股份總數為1,308,147,031股股份。本公司建議將予發行的人民幣股份數目為407,750,000股(即不超過人民幣股份發行完成後本公司經擴大股本的約23.76%)。超額配售權將不會獲行使。假設發行規模為407,750,000股人民幣股份，本公司於人民幣股份發行前後的股權結構如下：

股東數目	人民幣股份發行前		人民幣股份發行後	
	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比
上海華虹國際有限公司	347,605,650	26.57%	347,605,650	20.26%
鑫芯(香港)投資有限公司	178,705,925	13.66%	178,705,925	10.41%
Sino-AllianceInternational,Ltd.	160,545,541 ^(附註)	12.27%	160,545,541	9.36%
其他香港股份持有人	621,289,915	47.49%	621,289,915	36.21%
其他人民幣股份持有人	-	-	407,750,000	23.76%
總計	<u>1,308,147,031</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,715,897,031</u>	<u>100.00%</u>

附註：包括Sino-AllianceInternational,Ltd.根據一項託管安排，以託管方式持有的3,084股股份。

招股說明書主要條文概要的英文版為中文版的非正式譯本。倘出現任何差異，概以中文版為準。

本公司將就人民幣股份發行的發展於適當時候根據香港上市規則及其他適用法律及法規作出進一步披露。

本公告僅供說明，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部份。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

上海，二零二三年七月十八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

非執行董事：

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩 太平紳士

葉龍蜚